

98-2 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	電子封裝概論	科目序號 / 代號	0522 / MAI4024
開課系所	機械與自動化工程學系	學制 / 班級	大學日間部4年5班
任課教師	鄭江河	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	畢業班
上課時段 / 地點	(一)C / H466 (二)AB / H466	授課語言別	中文

課程簡介

電子封裝是半導體製造產業之後段製程，在本課程除教授傳統的塑膠構裝、陶瓷構裝、捲帶自動接合外，也介紹目前新型構裝技術，如覆晶、球陣列式構裝、晶片形構裝及異方性導電膠。

課程大綱

- 1 前言
- 2 聯線技術
- 3 塑膠構裝
- 4 陶瓷構裝
- 5 薄/厚膜技術
- 6 捲帶自動接合
- 7 覆晶接合
- 8 異方性導電膠
- 9 新型構裝技術

基本能力或先修課程

半導體製程、微機電系統概論

課程與系所基本素養及核心能力之關連

成績稽核

教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
無參考教科書				

參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
----	----	----	-----	-----

上課進度		分配時數(%)				
週次	教學內容	講授	示範	習作	實驗	其他
1	前言	100				
2	聯線技術	100				
3	塑膠構裝	100				
4	塑膠構裝	100				
5	陶瓷構裝	100				
6	陶瓷構裝	100				
7	薄/厚膜技術	100				0
8	期中考	0				100
9	薄/厚膜技術	100				
10	捲帶自動接合	100				
11	捲帶自動接合	100				
12	覆晶接合	100				0
13	覆晶接合	100	0	0	0	0
14	異方性導電膠	100	0	0	0	0
15	異方性導電膠	100	0	0	0	0
16	新型構裝技術	100	0	0	0	0
17	新型構裝技術	100	0	0	0	0
18	期末考	0	0	0	0	100